

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年5月25日
【会社名】	ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
【英訳名】	UMC Electronics Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内山 茂樹
【本店の所在の場所】	埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】	048-724-0001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長 岡本 圭三
【最寄りの連絡場所】	埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】	048-724-0001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長 岡本 圭三
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 1,322,030,000円 (注) 募集金額は、発行価額の総額であり、平成30年5月18日 (金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通 株式の終値を基準として算出した見込額であります。
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年5月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「第一部 証券情報 第1 募集要項

4 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」の記載内容の一部に訂正すべき事項がありましたので、これに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

4 新規発行による手取金の使途

(2) 手取金の使途

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示しております。

## 第一部【証券情報】

## 第1【募集要項】

## 4【新規発行による手取金の使途】

## (2)【手取金の使途】

(訂正前)

上記差引手取概算額上限1,316,030,000円については、本件第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額9,558,960,000円と合わせた手取概算額合計上限10,874,990,000円について、平成31年3月末までに3,183,000,000円を当社設備投資資金に、4,011,000,000円を子会社への投融資資金に、2,054,000,000円を長期借入金の返済に充当し、残額が生じた場合は運転資金に充当する予定であります。

また、具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

なお、当社グループの主な設備投資計画については、本有価証券届出書提出日現在、以下のとおりとなっております。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定年月		完成後の 増加能力 (注3.)
				総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了	
当社	本社・宮崎工場(埼玉県・宮崎県)	E M S 事業	工場用地・建物・製造設備取得(注1.)、S M T(注2.)ライン新設	3,183,000		増資資金及び自己株式処分資金	平成30年4月	平成31年3月	2%増加
UMC Electronics HongKong Limited	本社(中国・香港)	E M S 事業	S M T(注2.)ライン新設、工場増設	1,953,000		当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	9%増加
UMC Electronics Vietnam Limited	ベトナム工場(ベトナム・ハイズオン省)	E M S 事業	S M T(注2.)ライン新設	1,021,000		当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	7%増加
UMC Electronics (Thailand) Limited	タイ工場(タイ・チューンサオ県)	E M S 事業	S M T(注2.)ライン新設	596,000		当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	35%増加
UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.	メキシコ工場(メキシコ・ハリスコ州)	E M S 事業	S M T(注2.)ライン新設	441,000		当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	100%増加

(注1.) 当社本社に係る設備の内容は、平成30年4月3日付「株式会社日立製作所とモノづくり強化協業で基本合意」及び平成30年4月5日付「(訂正)「株式会社日立製作所とモノづくり強化協業で基本合意」の一部訂正について」において公表した株式会社日立情報通信マニュファクチャリングを対象としたM & Aに伴う株式会社日立製作所所有の製造拠点の製造資産の取得であります。

(注2.) S M T : Surface Mount Technology (表面実装技術)。プリント基板の表面に電子部品を直接半田付けするものであり、高密度実装が可能となる技術。

(注3.) 完成後の増加能力は、S M Tライン新設による生産能力の増加率を表しております。

(訂正後)

上記差引手取概算額上限1,316,030,000円については、本件第三者割当増資と同日付をもって決議された一般募集の手取概算額9,558,960,000円と合わせた手取概算額合計上限10,874,990,000円について、平成31年3月末までに3,183,000,000円を当社設備投資資金に、4,011,000,000円を子会社への投融資資金に、2,054,000,000円を長期借入金の返済に充当し、残額が生じた場合は運転資金に充当する予定であります。

また、具体的な資金需要の発生までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

なお、当社グループの主な設備投資計画については、本有価証券届出書提出日現在、以下のとおりとなっております。

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定年月		完成後の 増加能力 (注3. .)
				総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了	
当社	本社工場・秦野工場・宮崎工場(埼玉県・神奈川県・宮崎県)	E M S 事業	工場用地・建物・製造設備取得(注1. .)、S M T(注2. .)ライン新設	3,183,000		増資資金及び自己株式処分資金	平成30年4月	平成31年3月	103%増加
UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.	東莞工場(中国・広東省)	E M S 事業	S M T(注2. .)ライン新設、工場増設	1,953,000		当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	9%増加
UMC Electronics Vietnam Limited	ベトナム工場(ベトナム・ハイズオン省)	E M S 事業	S M T(注2. .)ライン新設	1,021,000		当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	7%増加
UMC Electronics (Thailand) Limited	タイ工場(タイ・チューンサオ県)	E M S 事業	S M T(注2. .)ライン新設	596,000		当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	35%増加
UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V.	メキシコ工場(メキシコ・ハリスコ州)	E M S 事業	S M T(注2. .)ライン新設	441,000		当社からの投融資資金	平成30年4月	平成31年3月	100%増加

(注1. .) 当社秦野工場に係る設備の内容は、平成30年4月3日付「株式会社日立製作所とモノづくり強化協業で基本合意」及び平成30年4月5日付「(訂正)「株式会社日立製作所とモノづくり強化協業で基本合意」の一部訂正について」において公表した株式会社日立情報通信マニファクチャリングを対象としたM & Aに伴う株式会社日立製作所所有の製造拠点の製造資産の取得であります。

(注2. .) S M T : Surface Mount Technology (表面実装技術)。プリント基板の表面に電子部品を直接半田付けするものであり、高密度実装が可能となる技術。

(注3. .) 完成後の増加能力は、S M Tライン新設及び製造設備取得による生産能力の増加率を表しております。